

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年8月17日(17.08.2023)



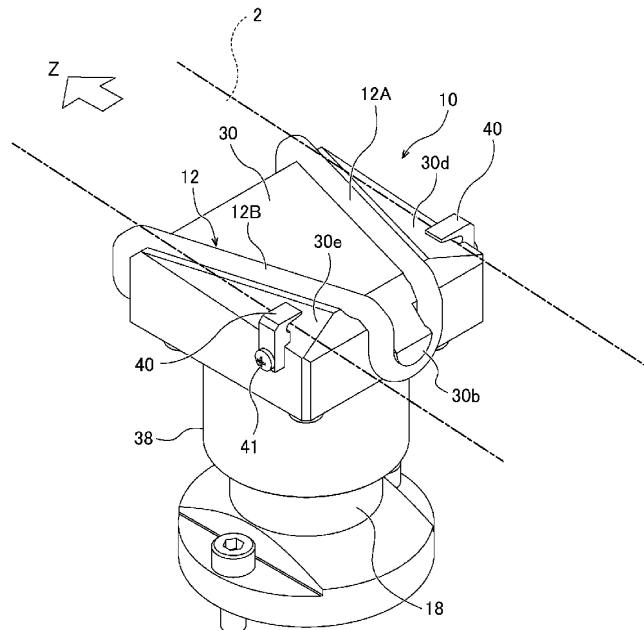
(10) 国際公開番号

WO 2023/153243 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 21/00 (2006.01) *B24B 21/06* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2023/002698
- (22) 国際出願日: 2023年1月27日(27.01.2023)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2022-018430 2022年2月9日(09.02.2022) JP
- (71) 出願人: 株式会社荏原製作所 (**EBARA CORPORATION**) [JP/JP]; 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 柏木 誠 (**KASHIWAGI, Makoto**); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP).
藤澤 真於 (**FUJISAWA, Mao**); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 廣澤 哲也, 外 (**HIROSAWA, Tetsuya et al.**); 〒1600023 東京都新宿区西新宿 7 丁目 5 番 8 号 GOWA 西新宿 4 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

(54) Title: POLISHING HEAD AND POLISHING DEVICE

(54) 発明の名称: 研磨ヘッドおよび研磨装置



(57) **Abstract:** The present invention pertains to a polishing head for pressing a polishing tape against a substrate such as a wafer. The present invention also pertains to a polishing device for polishing a substrate using such a polishing head. The polishing head (10) comprises: a pressing mechanism (12) which presses a polishing tape (2) against a substrate W; and a tape hook (40) which restricts the movement of an edge of the polishing tape (2) in a direction toward the substrate (W). The tape hook (40) has a tape-positioning surface (47) that faces the polishing surface of the edge of the polishing tape (2).

[続葉有]



WO 2023/153243 A1

HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE,
KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR,
LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 本発明は、ウェーハなどの基板に研磨テープを押し付けるための研磨ヘッドに関するものである。また、本発明はそのような研磨ヘッドで基板を研磨するための研磨装置に関するものである。研磨ヘッド(10)は、研磨テープ(2)を基板Wに対して押し付ける押圧機構(12)と、基板(W)に向かう方向への研磨テープ(2)の縁部の移動を制限するテープフック(40)を備えている。テープフック(40)は、研磨テープ(2)の縁部の研磨面に対向するテープ位置決め面(47)を有する。